

拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願 2 0 0 1 - 0 2 6 7 8 6
起案日	平成 1 4 年 5 月 1 6 日
特許庁審査官	中川 隆司 8 5 0 9 3 S 0 0
特許出願人代理人	池内 寛幸 (外 5 名) 様
適用条文	第 2 9 条第 2 項、第 2 9 条の 2、第 3 7 条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から 6 0 日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

(理由 1)

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願の日前の特許出願であって、その出願後に出願公開がされた下記の特許出願の願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同じではなく、またこの出願の時に於いて、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第 2 9 条の 2 の規定により、特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

・請求項 1

・引用文献等 1

・備考 引用文献等 1 の明細書には、第 1 の金属層の表層部に、配線パターンに対応した形状の凸部が形成され、凸部領域の上に、剥離層、第 2 の金属層が形成されている転写材が記載されている。

(理由 2)

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記 of 刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第 2 9 条第 2 項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

・請求項 1-21、36-51、69-83、96-109

・引用文献等 2-5

・備考 引用文献2には、凸部領域の上に、剥離層、金属層が形成されている転写材が記載されている。

引用文献3には、凸部領域の上の金属層を配線基板に転写した点が記載されている。

引用文献4には、銅箔、金、銅箔からなる転写法用複合材が記載されている。

引用文献5には、転写材を用いて多層配線基板を製造した点が記載されている。

・請求項 22-35、52-68、84-95、110-123

・引用文献等 4-6

・備考 引用文献6には、第1の金属層上に、第2の金属層と電氣的に接続するように印刷法により形成された回路部品を備えた転写材が記載されている。

引用文献4には、銅箔、金、銅箔からなる転写法用複合材が記載されている。

引用文献5には、転写材を用いて多層配線基板を製造した点が記載されている。

(理由3)

この出願は、下記の点で特許法第37条に規定する要件を満たしていない。

記

請求項1-21、36-51、69-83、96-109に記載される発明と請求項22-35、52-68、84-95、110-123に記載される発明に共通する課題は、転写材を用いて微細な配線パターンを基板に形成することにあるが、この課題は、本願出願前に解決されており(例えば、特開平07-022738号公報、特開昭57-207392号公報参照)、本願出願時未解決の課題ではないから、両発明は特許法第37条第1号の関係を満たさない。

また、上記両発明に共通する解決しようとする課題に対応した発明特定事項である「キャリアとしての第1の金属層、配線パターンとしての第2の金属層」は、文献を示すまでもなく本願出願前に周知の技術であるから、解決しようとする課題に対応した新規な発明特定事項である主要部が存在せず、上記両発明は、特許法第37条第2号の関係を満たさない。

さらに、上記両発明は、特許法第37条第3号、第4号、第5号に規定する他のいずれの関係も満たさない。

この拒絶理由通知書の内容に関する問い合わせ先
特許審査第二部搬送組立(組立製造)
電話03(3581)1101(内線3390)